

产品描述

XC6219系列是以CMOS工艺制造的高精度，低噪音，快速响应低压差线性稳压器。该系列的稳压器内置固定的参考电压，误差修正电路，限流电路，相位补偿电路以及低内阻的MOSFET，达到高纹波抑制，低输出噪音，快速响应低压差的性能。

XC6219系列兼容体积比钽电容更小的陶瓷电容，而且不需使用 $0.1\mu\text{F}$ 的 By-pass 电容，更能节省空间，降低了成本。因具有高精度的输出稳定性，以及快速瞬态响应性能，从而能应付负载电流的波动，所以特别适合应用在手持设备及射频产品上。

通过控制芯片上的CE脚，可将输出关断，关断输出后的静态电流只有 $0.1\mu\text{A}$ (Typ值)，从而大大降低了功耗。

产品特点

输出范围: 1.2V-3.6V

300mA输出电流

高电源抑制比: 70分贝1千赫

极低的静态偏置电流 : $70\mu\text{A}$ (典型)

在关机模式下小于 $1\mu\text{A}$

交界处的温度运作为 -40°C 至 $+85^{\circ}\text{C}$

XC6219采用SOT-23-5L封装

应用领域

CDMA / GSM移动电话

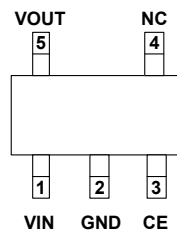
PDA/MP3

WLAN和蓝牙设备

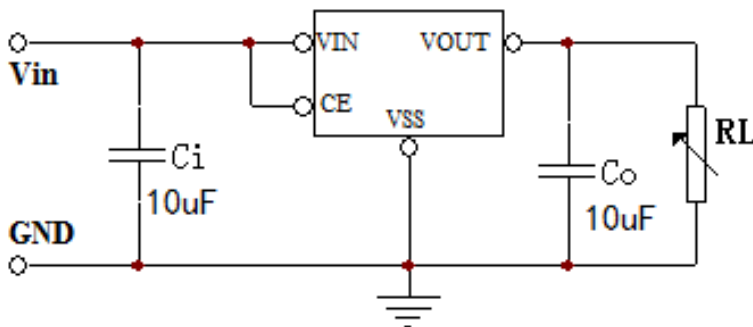
无绳电话

电池供电系统

LLVB



典型应用

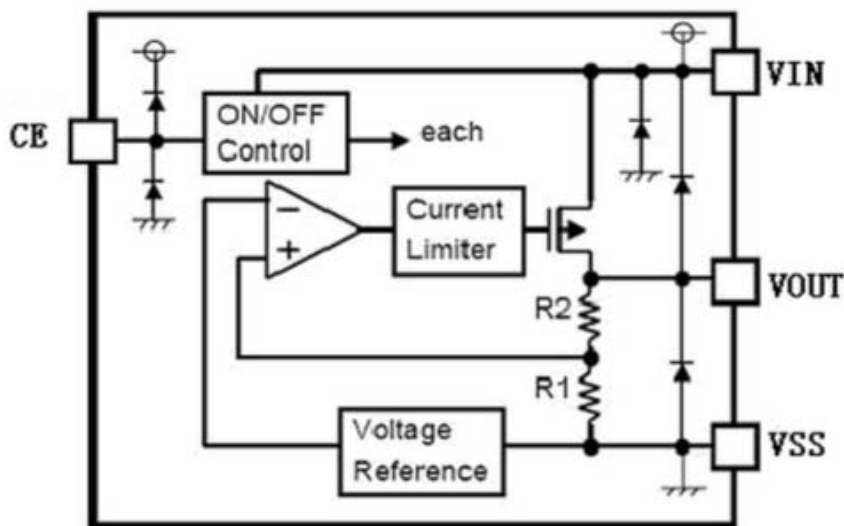


极限参数

项目	符号	说明	极限值	单位
电压	Vin	输入电压	6	V
	Vout	输出电压	$V_{ss}-0.3\sim V_{in}+0.3$	V
电流	Iout	输出电流	300	mA
功耗	PD	SOT-23-5L	250	mW
		SOT-23-3L	300	
温度	T _{OPR}	工作温度	$-20\sim+85$	$^{\circ}\text{C}$
	T _{stg}	存储温度	$-40\sim+125$	$^{\circ}\text{C}$
	T _{solder}	焊接温度	260 $^{\circ}\text{C}$, 10s	

注：极限参数是指无论在任何条件下都不能超过的极限值。万一超过此极限值，将有可能造成产品劣化等物理性损伤；同时在接近极限参数下，不能全部保证芯片可以正常工作。

功能框图



电学参数

($V_{IN}=V_{OUT}+1V$, $C_{IN}=1\mu F\sim 10\mu F$, $C_{OUT}=1\mu F\sim 10\mu F$, $T_a=25^\circ C$ 。除特别指定)

特性	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
输出电压	$V_{OUT}(E)$ (Note 2)	$I_{OUT}=40mA$, $V_{IN}=V_{OUT}+1V$	X 0.98	$V_{OUT}(T)$ (Note 1)	X 1.02	V
输入电压	V_{IN}				6.0	V
最大输出电流	I_{OUTmax}	$V_{IN}=V_{OUT}+1V$		300		mA
负载特性	ΔV_{OUT}	$V_{IN}=V_{OUT}+1V$, $1mA \leq I_{OUT} \leq 100mA$		50		mV
压差 (Note 3)	V_{dif1}	$I_{OUT} = 100mA$		90		mV
	V_{dif2}	$I_{OUT} = 200mA$		230		mV
静态电流	I_{SS}	$V_{IN}=V_{OUT}+1V$		70		μA
关断电流	I_{CEL}	$V_{ce} = 0V$		1		μA
电源电压调整率	$\frac{\Delta V_{OUT}}{\Delta V_{IN} \cdot V_{OUT}}$	$I_{OUT} = 40mA$ $V_{OUT}+1V \leq V_{IN} \leq 8V$		0.05		%/V
输出噪声	en	$I_{OUT} = 40mA$, 300Hz~50kHz		50		μV_{rms}
纹波抑制比	PSRR	$V_{IN} = [V_{OUT}+1]V$ $+1V_{p-pAC}$ $I_{OUT} = 40mA, f=1kHz$		70		dB

注释: 1、 $V_{OUT}(T)$: 规定的输出电压

2、 $V_{OUT}(E)$: 有效输出电压 (即当 I_{OUT} 保持一定数值, $V_{IN} = (V_{OUT}(T)+1.0V)$ 时的输出电压。

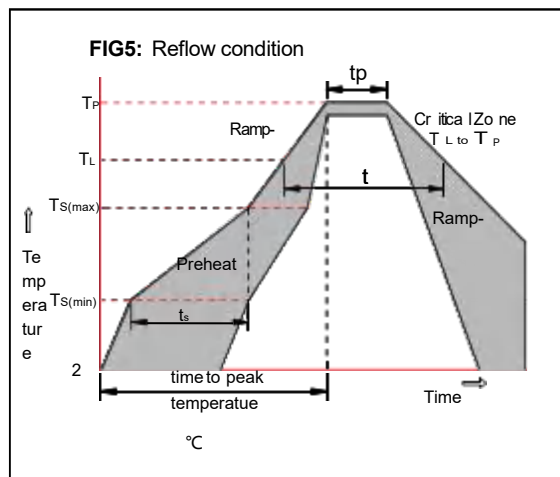
3、 V_{dif} : $V_{IN1} - V_{OUT}(E)'$

V_{IN1} : 逐渐减小输入电压, 当输出电压降为 $V_{OUT}(E)$ 98% 时的输入电压。

$V_{OUT}(E)' = V_{OUT}(E) \times 98\%$ 。

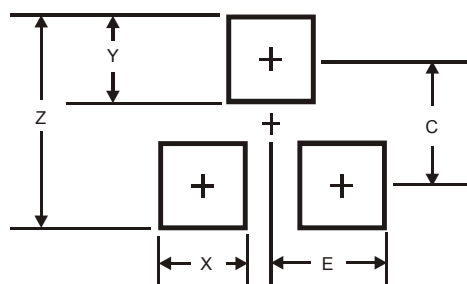
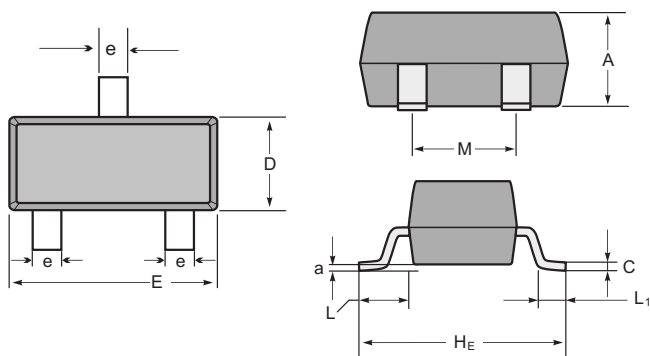
Soldering parameters

Reflow Condition		Pb-Free assembly (see as below)
Pre Heat	-Temperature Min ($T_{s(min)}$)	+150°C
	-Temperature Max($T_{s(max)}$)	+200°C
	-Time (Min to Max) (ts)	60-180 secs.
Average ramp up rate (Liquid us Temp (T_L) to peak)		3°C/sec. Max
$T_{s(max)}$ to T_L - Ramp-up Rate		3°C/sec. Max
Reflow	-Temperature(T_L)(Liquid us)	+217°C
	-Temperature(t_L)	60-150 secs.
Peak Temp (T_P)		+260(+0/-5)°C
Time within 5°C of actual Peak Temp (t_P)		30 secs. Max
Ramp-down Rate		6°C/sec. Max
Time 25°C to Peak Temp (T_P)		8 min. Max
Do not exceed		+260°C



Package Dimensions & Suggested Pad Layout

SOT23

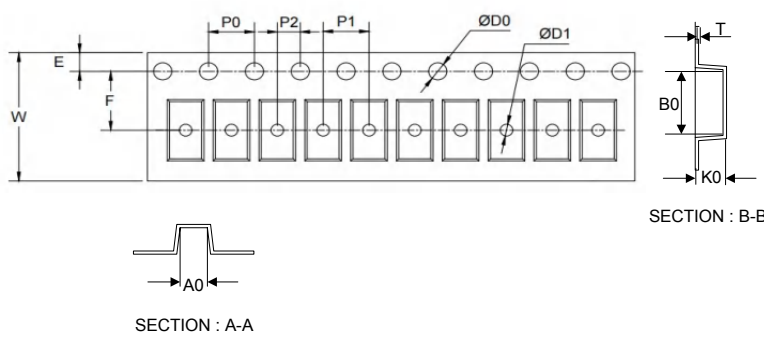
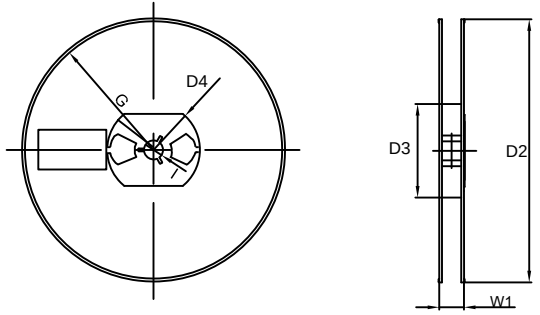


SOT-23 mechanical data

UNIT	A	C	D	E	HE	e	M	L	L1	a
mm	max	1.1	0.15	1.4	3.0	2.6	0.5	1.95	0.55 (ref)	0.36 (ref)
	min	0.9	0.08	1.2	2.8	2.2	0.3	1.7		0.15
mil	max	43	6	55	118	102	20	77	22 (ref)	14 (ref)
	min	35	3	47	110	87	12	67		6

Dimensions	SOT23
Z	2.9
X	0.8
Y	0.9
C	2.0
E	1.35

Tape & reel specification

Tape		Symbol	Dimension (mm)
		P0	4.00±0.10
		P1	4.00±0.10
		P2	2.00±0.10
		D0	1.55±0.10
		D1	1.05±0.10
		E	1.55±0.10
		F	3.60±0.10
		W	8.00±0.10
		A0	3.80±0.20
		B0	3.25±0.20
		K0	1.45±0.10
		T	0.25±0.05
		D2	178.0±3.0
		D3	55Min.
		D4	R24.0±3.0
7" Reel		G	R82.0±3.0
		I	13.0±2.0
		W1	11.0±3.0
		Quantity: 3000PCS	